

有机硅导热灌封胶 SP101

一、SP101 使用说明

SP101 是一种低粘度阻燃性双组分加成型有机硅导热灌封胶，操作时间较短，凝固速度较快，可以室温固化，也可以加热固化。该产品广泛应用于 HID，电源模块，变压器，继电器，电路板等电子元件灌封和密封，其阻燃性可以达到 UL94-V0 级。完全符合欧盟 ROHS 指令要求。

二、固化前技术参数

	A 组分	B 组分
颜色，可见	深灰色	白色
粘度 (25°C cps)	4200	4200
密度 g/cm ³	1.52	1.52
混合粘度	4200	
保存期 (25°C)	12 个月	

三、固化后性能参数：

物理性能

硬度测定 (邵氏硬度 A)	50-60
热膨胀系数 (°C)	2.3X10 ⁻⁵
导热系数 (W/MK)	0.8-1.0
有效温度范围 °C	-60-260

四、使用条件

混合比	A: B=1: 1 (重量比)
胶化时间	25°C × 6-8 小时
可使用时间	25°C × 0.5 小时 (混合量 100g)
硬化条件	25°C—24 小时, 80°C—2 小时, 100°C—30 分钟

五、电气性能

体积电阻 Ohm. cm	1.0 × 10 ¹⁶
表面电阻 Ohm	1.2 × 10 ¹⁵
耐电压 KV/mm ²	25
绝缘常数 1KHZ	4.2
耗散系数 1KHZ	0.02

六、使用方法

- 1、混合前，首先把 A 组分和 B 组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
- 2、将 A, B 按照重量比 1: 1 混合均匀。
- 3、真空脱泡。
- 4、灌入元件或模型中。

如果需要灌封的产品中含有磷化物，硫化物，或氨化物可能会使 SP101 产生不完全固化或未固化现象，所以，最好在进行简易实验验证后应用，必要时，需要清洗应用部位。

七、注意事项

- 1、胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。
- 2、本品属非危险品，可以按照非危险品保存。
- 3、存放一段时间后，胶可能会有所分层。请搅拌均匀后再使用。

八、包装及存储说明

本品为 20Kg/套。(A 组分 10Kg , B 组分 10Kg) , 阴凉干燥下存储, 本产品的贮存期为 1 年。